

実装基板 外観検査装置

Summit TB3-CS-M

2025 model All New Debut!

2,000万画素カメラ3基搭載
0402サイズチップ対応

高速CPU搭載
検査速度向上

カメラユニット
Y軸移動撮影

上下分割
ユニット構成



現場の元気が「モノづくり力」の原材料だ！
私たちは製造フロアの元気をサポートします

 Wing Vision
Best collaboration of human and machine

Camera & Robot



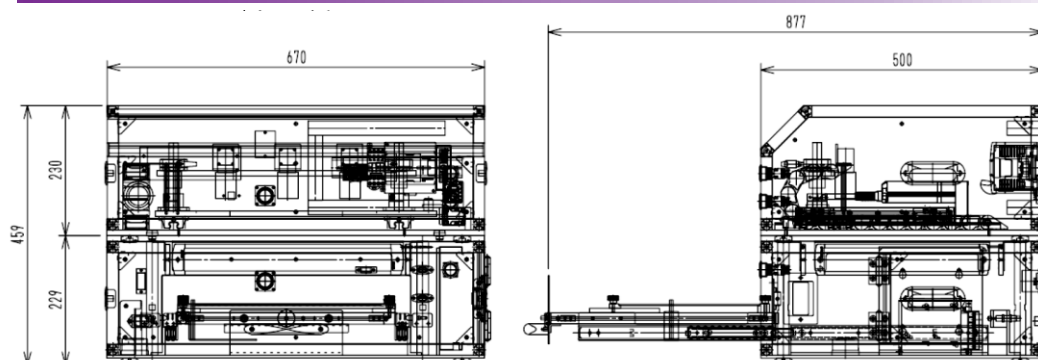
横一列に3台のカメラを配置、1軸ロボットでY方向に駆動してMサイズの基板を最大9ショットに分割撮影・検査を行います。移動位置は任意に設定することも可能。

分割数を従来の4から9に増やすことで1ショットの視野範囲を狭くし、0402chipの検査が可能な解像度を実現しています。最小部品サイズが0603がそれ以上であっても、余裕を持った解像度でより安定した検査が可能です。

※ 4カメラ固定式の従来型 Summit TB-M は2025年10月から TB3-CS-Mと共通のフレームに変更し、継続予定です。データの互換性は前機種から確保されます。

※ 2025年秋から、リフロー前専用インライン機 Summit CV3-CS-M を発売する予定です。卓上機と共通のカメラ駆動ユニットを採用し、0402chip対応。

Frame



カメラ駆動用ロボット、制御PCを内蔵しているにも関わらず、横幅670mm、奥行500mmのコンパクトさを実現しました。

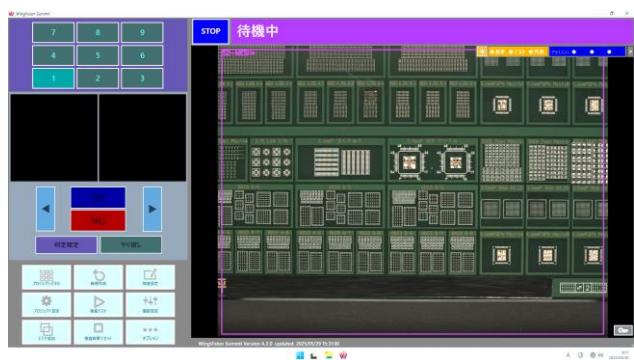


撮像ユニットとベースユニットを組み合わせるというユニークな発想で、様々な筐体バリエーションへの対応を可能にしました。

撮像ユニットは3カメラ移動式と4カメラ固定式の他、将来はより解像度の高いカメラの搭載も考慮した設計。ベースユニットは卓上スライドテーブルだけではなく、コンベア内蔵インライン機や、既存コンベア上設置も技術的に可能です。

また、筐体カバーのカラーバリエーションも承ります。

Software



2025年後半、以下の新機能をリリース予定です。

- 部品種類自動判別、自動設定機能
 - ・定数表記のあるチップ抵抗の場所に自動的に180°回転代替画像を登録
 - ・アルミ電解など外観精度の低い部品を判別し、パラメータを自動設定
- 反りのある基板の位置補正機能強化
 - ・複数の補正点で部分的な補正を可能にする
- AI-OCR機能
 - ・ICの品名を読み取ることで正誤判定や基板シリアルと紐づけて保存する機能